

Title (en)

Method for electrically linking flat conductors with round conductors

Title (de)

Verfahren zum elektrischen Verbinden von Flachleitern mit Rundleitern

Title (fr)

Procédé de raccordement électrique de conducteurs plats dotés de conducteurs ronds

Publication

EP 2387111 A1 20111116 (DE)

Application

EP 10305506 A 20100512

Priority

EP 10305506 A 20100512

Abstract (en)

The method involves inserting a round conductor (4) into grooves in a part (7) of a connector, where depth of the grooves is smaller than diameter of the round conductor. A flat conductor-ribbon line (1) is pressed against the round conductor by another part (9) of the connector when the parts are connected with each other. A flat conductor and the round conductor are electric-conductively connected with each other at ends, where the ends of the round conductor project from the connector along same direction. The connector is made of insulating material.

Abstract (de)

Es wird ein Verfahren zum elektrisch leitenden Verbinden der elektrischen Flachleiter einer Flachleiter-Bandleitung mit Rundleitern angegeben, die einen runden elektrischen Leiter mit kreisförmigem Querschnitt haben, der von einer Isolierung umgeben ist. Es wird ein Verbinder aus Isoliermaterial eingesetzt, der aus zwei miteinander zu verbindenden Teilen besteht, von denen ein erster Teil parallel zueinander verlaufende Rillen zur Aufnahme von Rundleitern aufweist, deren Tiefe kleiner als der Durchmesser der isolierten Rundleiter ist. Zunächst werden die Rundleiter in die Rillen des ersten Teils des Verbinders eingelegt, wobei sie über das Profil desselben hinausragen. Danach wird die Flachleiter-Bandleitung mittels des zweiten Teils des Verbinders bei dessen Verbinden mit dem ersten Teil desselben mit vorgegebener Lage gegen die Rundleiter gepreßt. Abschließend werden jeweils ein Flachleiter der Flachleiter-Bandleitung und ein runder Leiter, die mit ihren Enden in gleicher Richtung aus dem Verbinder herausragen, an diesen Enden elektrisch leitend miteinander verbunden.

IPC 8 full level

H01R 12/63 (2011.01)

CPC (source: EP)

H01R 12/63 (2013.01)

Citation (search report)

- [X] US 6247977 B1 20010619 - TANAKA YOSHIYUKI [JP], et al
- [X] WO 2006110363 A1 20061019 - 3M INNOVATIVE PROPERTIES CO [US], et al
- [X] US 6017244 A 20000125 - DAANE LAURENCE ALAN [US]
- [A] US 3897130 A 19750729 - DONNELLY ROBERT WILLIAM, et al

Cited by

CN104241938A; EP2818903A3; US9606297B2

Designated contracting state (EPC)

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)

BA ME RS

DOCDB simple family (publication)

EP 2387111 A1 20111116

DOCDB simple family (application)

EP 10305506 A 20100512